

JDB805 有机硅导热胶

产品描述

JDB805 为单组分有机硅导热胶，通过与空气中的湿气发生室温固化，具有高导热率、低界面热阻及良好的粘结性，适用于电子元件与散热器和壳体等之间的粘结散热。

产品特性

- 产品表干时间短 (<30min)，深层固化快，有利于快速粘结；
- 阻燃性能优异，通过了UL94 V0认证 (UL FileNo.E343835)；
- 优异的粘接性能，对大多数金属及塑料、陶瓷和玻璃有较好的粘附性；
- 优异的耐侯、耐湿、耐热性能；良好的电气绝缘性能；
- 固化后胶层为弹性体，固化后释放醇类物质，对PC、ABS、金属等材质无腐蚀；
- 在-50℃~200℃范围内机械和电气性能稳定。完全符合欧盟 ROHS 指令要求。

技术参数

项目	典型值	测试标准
固化前特性(25℃±3℃, 55%±5%RH)		
外观	白色膏状物	--
密度 (g/cm ³)	1.75±0.10	GB/T 13354—1992
表干时间(min)	<30	GB/T 13477.5—2002
固化后特性(25℃±3℃, 55%±5%RH @ 7days)		
硬度 (Shore A)	65±10	GB/T 531.1—2008
扯断强度(MPa)	≥1.5	GB/T 528—2009
伸长率(%)	≥50	GB/T 528—2009
粘结强度 /铝 (MPa)	≥1.80	GB/T 7124—2008
导热率 (W/m·K)	0.9±0.1	GB/T 10297—1998
体积电阻率(Ω·cm)	≥1.0×10 ¹⁴	GB/T 1410—2006
介电强度 (kV/mm)	≥20	GB/T 1408.1—2006
介电常数 (1.0MHZ)	3.5	GB/T 1409—2006
介质损耗(1.2MHZ)	0.02	GB/T 1410—2006
阻燃等级 (UL94)	V-0	ASTM
工作温度(℃)	-50~200	--

使用说明

- 将被施胶物体的表面清理干净及干燥，对金属或陶瓷进行等离子处理。
- 将胶液用专用工具挤出，涂布于已清理干净之接着面。
- 通常在室温及相对湿度为30%-80%的条件下固化，在24-72小时内固化物理性能可达完全性能的90%以上。

注意事项

- 使用前，请详细查阅MSDS。
- 施工场地必须保持良好的空气流动。
- 穿戴好防护用品，如护眼镜、专用手套、鞋帽等。
- 应避免接触皮肤和眼睛，若不慎接触皮肤用干毛巾擦拭干净，并用肥皂清洗干净；若不慎接触眼睛，立即用清水冲洗，有必要时到医院检查。
- 本产品在使用后，应将胶管密封，可保存再次使用。本产品仅供工业用途。

包装规格

- 300ml/支,每箱 24 支装;2600ml/支瓶装，每箱 4 支装。

贮存及运输

- 远离儿童存放。
- 本产品应密封贮存于阴凉干燥环境中，避免太阳直晒，温度在 28℃以下，相对湿度在 60%以下。贮存有效期为 6 个月。生产批号及保质期见胶管。
- 本产品为非危险品，按一般化学品贮存、运输。

请仔细阅读：

- 本文中所含的各种数据为本公司在实验室标准条件下测试所得，仅作为参考，使用时以实际测试数据为准，本说明书所涉及的产品使用方法均只是我公司的建议，为确保材料在最终使用条件下的安全和适用，客户有必要通过实验确认产品的适用性，对在其它不同的仪器或条件下测试得到的资料，本公司不做任何承诺，客户自行将产品用于不适宜的用途所产生的后果，我公司申明不承担任何责任。